

证券代码：688456

证券简称：有研粉材

有研粉末新材料股份有限公司

投资者关系活动记录表（2024年12月3日）

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	中信证券、中邮创业基金、星石投资、天壹资本
会议时间	2024年12月3日9:30-10:30
会议地点	有研大厦
上市公司接待人员	董事会秘书、财务总监、总法律顾问：姜珊 证券事务代表：王妍 证券事务专员：瓮佳星
投资者关系活动主要内容介绍	<p>Q1：请简要介绍公司今年的整体经营情况。 A1：公司前三季度整体销量 23,000 吨，同比增长 10%，营业收入 23 亿元，同比增长 18%，其中销量增长带来的增量是 11%，由于原材料价格上涨带来的增量是 7%。利润总额 4,489 万元，同比增长 3%。四季度市场开拓效果良好，11 月公司铜粉销量再创新高，有研合肥、有研重冶、英国 Markin 公司均创造了本公司有史以来单月销量的最高记录。</p> <p>Q2：请简要介绍公司近期有重大突破的新产品的开发情况。 A2：铜基板块目前实现突破的新产品主要为导热铜粉，主要用于制造风冷散热组件，与传统雾化铜粉相比，具有梯度孔隙结构、比表面积发达、松装密度低等特点。此款铜粉在散热效率方面较传统雾化铜粉，性能提升 10%-20%，热端收益 3-5℃，属于行业内比较大的进步。</p> <p>Q3：导热铜粉具体市面上的应用有哪些？</p>

A3: 该产品是公司与某终端用户合作开发的产品, 现已成功应用于部分 GPU 散热器件。据了解该产品目前也已部分应用于 AI 算力服务器、基站、大型路由器、交换机等场景, 应用效果截至目前反馈良好。

Q4: 导热铜粉的下游需求目前如何?

A4: 目前已经实现每月吨级供货, 供应稳定。该产品在其他领域的应用也在测试阶段, 下游需求根据公司研发进度有望进一步扩大, 公司的柔性产线使得现有产能能够迅速匹配市场需求。

Q5: 行业内只有我们能生产导热铜粉吗? 该技术短期内是否容易被竞争对手突破?

A5: 目前只有公司能生产新型导热铜粉。公司经过多年发展, 在长期研发积累的大量实验数据、工艺经验基础上, 形成了完善的研发技术体系, 拥有国家级创新平台, 材料研发团队可以参与到客户的设计端, 共同设计、开发需要的粉体材料, 定制适合于下游客户应用的粉体产品。本次新产品研发就起源于下游客户的应用需求, 共同研发了两年, 在加工方式上实现了突破, 解决了以新的生产方式制造的导热铜粉在产品应用上的问题, 在行业内属于首创。

Q6: 公司产品还有哪些其他亮点?

A6: 公司未来研发方向是向新的应用领域拓展、延伸, 也会继续延伸产业链, 如铜基板块, 在保持现有市占率前提下, 加强新产品的研发力度, 如复合铜粉、超细铜粉、低松比铜粉等高附加值产品。如电子浆料领域, 专注于超细镍粉、超细铜粉、超细银粉、银包铜粉及其浆料等新产品的研发, 增加互连材料的种类, 可应用于 PCB、MLCC 等产品。结合国家设备更新、发展新质生产力的政策, 不断调整产品结构, 开发新的应用领域, 形成新的产业链, 扩大市场需求。

Q7: 铜粉产品的定价方式是怎样的?

A7: 公司铜基板块产品的定价方式主要是原材料+加工费的模式。

Q8: 关注到 3D 打印产品的毛利水平达 40%, 今年的出货量预计如何?

A8: 本年 3D 打印粉体销量整体向好, 截至十月, 公司 3D 打印粉体销售量达到 2023 年全年销售量的 2 倍, 预计年底可以达到 3 倍。

	<p>Q9：增材这块有涉及消费电子？ A9：增材板块不涉及消费电子行业，公司的锡基板块下游行业为消费电子行业。</p> <p>Q10：公司在光伏领域有没有铜浆的应用？ A10：公司在几年前参加过科技部的国际合作项目、北京市重点研发计划，有对铜浆的应用研究，当时主要应用于三代半导体。有了这样的技术积累，今后铜浆研发应用于哪些场景，主要考虑市场的应用成本，高温银浆和低温银浆技术路线不同，银包铜替代的有可能以高温银浆为主，银包铜场景的异质结、IBC等低温银浆，铜浆在粉体、载体部分都会有技术区别，公司也在关注并紧跟市场技术路线，等待市场批量化使用的行业信号。</p> <p>Q11：公司对各板块未来发展如何规划。 A11：公司铜基板块经过多年的发展，在国内市占率方面已取得显著优势，未来公司会继续加强新产品的研发力度，如研发复合铜粉、超细铜粉、低松比铜粉、导热铜粉等产品，未来会做好产品细分，根据市场需求灵活调整产品结构。目前公司锡基板块的产能能够满足市场需求，板块整体的发展致力于技术迭代并向下游新兴产业链延伸，同时公司通过调整产业结构，生产附加值更高的产品，争取达到20%-30%的年增长率。公司对增材板块寄予厚望，依托科创中心的募投项目，对3D打印板块进行大规模投入，未来会逐步推进向下游的延伸发展。同时在提高3D打印粉末制备能力上持续加劲，预计明年会实现量产的重大突破。电子浆料板块还处于技术研发阶段，主要聚焦国家任务，属于未来产业。公司之后将继续融入国家战略，保障产业链供应链安全稳定，加快传统产业转型，打造战略性新兴产业，在中国式现代化建设中展现央企责任担当，以更加优异的业绩回报广大投资者。</p>
关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明	不涉及
附件清单（如有）	
日期	2024年12月9日